6.제품 사양

고내열 타입

극수	10~60	적용 FPC/FFC 두께	(Signal)0.3±0.03mm (Grand)0.5±0.03mm
핀간격	0.5mm	정격전류	DC 0.5A/Contact
기판상 높이	(ST)6.0mm (RA)4.1mm	정격전압	DC 50V/Contact
폭	(ST)4.15mm (RA)6.7mm	재질	동합금/내열수지
락 타입	Non-ZIF 원액션 타입	사용온도범위	-40~+125℃
접점위치	(ST)단접점 (RA)하접점	내전압	AC200Vrms/min.

통상 타입

극수	10~60	적용 FPC/FFC 두께	(Signal)0.3±0.03mm (Grand)0.5±0.03mm
핀간격	0.5mm	정격전류	DC 0.4A/Contact
기판상 높이	(ST)6.0mm (RA)4.1mm	정격전압	DC 50V/Contact
폭	(ST)4.15mm (RA)6.7mm	재질	동합금/내열수지
락 타입	Non-ZIF 원액션 타입	사용온도범위	-40~+85℃
접점위치	(ST)단접점 (RA)하접점	내전압	AC200Vrms/min.